

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2024-039

深圳市则成电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年6月25日

活动地点：进门财经网络平台

参会单位及人员：开源证券、创金合信基金、工银瑞信基金、东海证券、长江证券、中泰证券、万和证券、工银国际、玄元私募基金投资管理（广东）有限公司、共青城鼎睿资产管理有限公司、福建豪山资产管理有限公司、杭州弈宸私募基金管理有限公司、上海留仁资产管理有限公司、和谐健康保险股份有限公司、果实资本、上海冰河资产管理有限公司、上海汇瑾资产管理有限公司、湖南正银投资管理有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、深圳丰岭资本管理有限公司、上海临信资产管理有限公司、深圳大道至诚投资管理合伙企业(有

限合伙)、和基投资基金管理(苏州)有限公司、上海度势投资有限公司、深圳市明达资产管理有限公司、北京才誉资产管理企业(有限合伙)、海南鸿盛私募基金管理有限公司、拓璞基金

上市公司接待人员:公司董事长:薛兴韩先生;公司总经理、董事:蔡巢先生;公司财务总监、董事会秘书:魏斌先生;公司证券事务代表:刘旭南先生

三、 投资者关系活动主要内容

本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下:

问题 1: 关于 HDI PCB 方面, 我们可以看到在 AI 服务器的成本中 PCB 的占比在提升, 公司能否分享整个市场的趋势?

回复: 基于 GPU 背景下的 AI 服务器对 PCB 的需求, 从目前来看, 是呈现“冰火两重天”的状态。据我们了解, 一些高端的台资企业 PCB 工厂, 因为接到英伟达等客户的订单, 目前已经是爆单的状态, 而相反传统的特别是国内 PCB 工厂, 因为长期聚焦中低端 PCB 市场, 目前处于产能过剩的状态。

我们在最近的产品推广过程中, 与大部分全国前十的光模块制造商进行了多种形式交流, 特别是与研发人员的面对面交流。我们得到的反馈是, 正在研发或能进行批量生产 800G 以上光模块的高端制造商, 目前都遇到了共同的问题, 第一个就是 DSP 芯片的供给, 目前处于供不应求的状态, 第二个就是目前 800G 及以上的光模块所需要的高端 PCB 同样存在供应链短缺的问题。目前高端 PCB 的主力供应商一家是内地企业, 一家在台湾, 这两个头部的 PCB 供应商的交付周期很长, 而公司全资子公司广东则成科技有限公司目前正在为客户提供的 800G 和 1.6T 的光模块 PCB 样品, 通过相对快捷的交付周期, 帮助客户加快进入到产品验证的过程中, 我们对这个领域的未来发展充满信心。由于受国家宏观经济环境、行业发展情况及公司经营情况等多种因素共同影响, 公司在这个领域的未来发展仍具有一定的不确定性, 请投资者注意投资风险。

问题 2: 公司之前一直深耕柔性应用领域, 目前的线路板产品也以柔性线路板为主, 为何会选择进入光模块 PCB 领域? 而在这个领域中, 公司相比于其他竞争对手的优势都有哪些方面?

回复: 公司过去三年一直围绕着 NBCF 的 RCC 类材料以及 FIPIS 技术(细间

距减除法)进行研发投入和技术攻关,目的是通过自研材料和技术路径,实现高细密线路的制造,这也是公司进入 HDI PCB 领域的基础。另外,我们通过市场调研发现在 800G 光模块上,出现 4 纳米制程的 DSP 芯片,这是一个技术的分水岭,因为把这种芯片封装在 PCB 上,需要采用 FCBGA 的封装技术。制造应用于 FCBGA 封装的 PCB,目前行业主流的技术路径分别是采用 ABF 材料通过半加成法(SAP)工艺实现以及使用 PP 材料通过改良型半加成法(mSAP)工艺实现两种路径,但这两种工艺路径目前会在材料、设备等方面受制于国外的供应商。而则成电子基于 NCBF 材料以及 FIPIS 技术生产制造的 1.6T 光模块 PCB 样品,送样到某头部光模块厂商进行各式各样的性能测试,在与一线大厂同时送样的 PCB 比较中,在高频和高速等某几方面关键指标,则成电子产品的性能是能媲美甚至超越友商,这个结果让我们感到骄傲的同时,也增强了我们对光模块产品线的信心。

问题 3: 公司能否针对 NCBF 材料做更多的介绍?

回复:在整个 PCB 线路板的结构中,有 80%是由导体层跟介质层所构成,在 HDI 乃至更精细的线路领域(如 IC 载板等),介质层的物理及化学特性十分重要。NBCF 是一种高端的、可以实现更薄更高精度的介质层 RCC 类材料,应用在增层制程中能提供很高的稳定性以及均匀性。除了可应用于 HDI PCB 的制造以外,未来 NBCF 还可以作为介质层拓展应用到玻璃基板、有机中介层、FOPLP 晶圆整体封装、RDL 重置电路封装技术、Chiplet 芯粒封装等高端线路板制造及半导体封装领域之中。

问题 4: 公司能否分享对光模块的整体市场容量的判断? 目前 800G 光模块的 PCB 单价大约是多少?

回复:公司通过市场调研以及参考专业行研分析报告,根据行业知名调研机构 Lightcounting 预测,预计 2024 年,800G 光模块市场容量达 70 亿美元。通过 BOM 成本分析以及整体毛利测算,我们认为对应的 PCB 采购额应该会在 30 亿-50 亿人民币的区间。而光模块 PCB 的单价受技术成熟度以及市场供需关系等多重因素影响,目前 800G 光模块 PCB 单片报价的中位数是在 300-400 美元之间。

问题 5: 关于则成电子传统产品线,无论是消费电子,还是医疗电子以及汽车电子领域,公司能否对 2024 年的整体情况进行预估,并对于明年做一个简单的展望?

回复：传统业务线方面，公司正在努力通过新客户以及新项目的导入实现稳健增长。具体细分来看，我们预计消费类和医疗类两大板块会实现新的突破，公司未来在医疗领域会继续深耕，同时在消费电子领域通过实施大客户策略实现销售增长。汽车项目方面，由于整体的导入周期较长，今年开发的新客户新项目，具体量产可能要到明年才能实现。

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2024年6月27日